



2017 3rd International Symposium on Mechatronics and Industrial Informatics

第三届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会

ISMII 2017 October 27-29, 2017 Haikou, China

征 稿 通 知

会议官网

<http://www.ismii.org>

检索类型

EI/ISTP

会议时间

2017 年 10 月 27 日—29 日

截稿时间

2017 年 9 月 5 日

会议地点

中国海口

主办方

AEIC 学术交流资讯中心

会议秘书：林老师

- (1) 大会网站: <http://www.ismii.org>
- (2) 联系邮箱: ISMII2015@163.com (投稿与咨询)
- (3) 联系电话: 020-28101036/+86-18102545612 (微信)
- (4) 即时通讯: (QQ) 2578989287
- (5) AEIC 学术交流群: 526039541 (QQ)



林老师微信

第三届机电一体化与工业信息学国际学术研讨会（ISMII 2017）定于 2017 年 10 月 27 日至 29 日在中国海口市隆重举行。会议主要围绕“机电一体化”“工业信息”等研究领域展开讨论。旨在为机电一体化与工业信息学的专家学者及企业发展人提供一个分享研究成果、讨论存在的问题与挑战、探索前沿科技的国际性合作交流平台。欢迎海内外学者投稿和参会。

论文出版

录用的会议论文将被 Atlantis Press 出版社旗下 proceeding 系列《Advances in Computer Science Research》(ISSN 2352-538X) 出版，出版后提交 EI/ISTP 等检索机构检索。

ISMII 会议已经上线到出版社会议列表：</uploads/201707/9e76c23b8dda853c5471e998bb00fe8e.png>

注册费用

第一篇论文投稿：2000 元/篇（超出 4 页：加收 200/页）

第二篇论文投稿：1800 元/篇（超出 4 页：加收 200/页）

★ 学生投稿可优惠 200

征文主题

- (1) 机电一体化
- (2) 工业信息学
- (3) 其它相关主题

征文要求

- 1、论文须是英文稿件，且论文应具有学术或实用价值，未在国内外学术期刊或会议发表过。发表论文的作者需提交全文进行同行评审，只做报告不发表论文的作者只需提交摘要。
- 2、作者可通过 CrossCheck, Turnitin 或其他查询系统自费查重，否则由文章重复率引起的被拒稿将由作者自行承担责任。涉嫌抄袭的论文将不被出版，且公布在会议主页。
- 3、论文需按照会议官网的模板排版。

大会主席

Renjie Dong, China Agricultural University

Lam Kin Che, The Chinese University of Hongkong, HK

大会科学技术委员会

Vladimir Alekseevich Sokolov, Saint-Petersburg State Polytechnic University

Jinping Jia, Shanghai Jiaotong University, China
George A . O'Doherty, Northeastern University, USA
Minsheng Huang, East China Normal University
Jingtao Han, University of Science & Technology Beijing, China
Aijie Wang, Harbin Institute of Technology, China
Huiwang Gao, Ocean University of China
Boxue Du, Tianjin University, China
Renjie Dong, China Agricultural University
Ming Dong, Shanghai Jiao Tong University, China
Carlos Caceres, The University of Queensland, Australia
Shupei Cheng, Nanjing University, China
Haozhong Cheng, Shanghai Jiao Tong University, China
Lam Kin Che, The Chinese University of Hongkong, HK
Zhenqian Chen, Southeast University, China
Wenbin Cai, Fudan University, China
Heinz-Gunter, Brokmeier, Technische Universitat Clausthal, Germany
Jinglong Bu, Hebei United University, China
Shahrum Abdullah, University Kebangsaan Malaysia, Malaysia

